

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成30年1月25日(2018.1.25)

【公開番号】特開2017-17048(P2017-17048A)

【公開日】平成29年1月19日(2017.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2017-003

【出願番号】特願2015-128756(P2015-128756)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46 (2006.01)

H 05 K 1/02 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/46 N

H 05 K 3/46 Z

H 05 K 1/02 E

H 05 K 3/46 B

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月11日(2017.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

第1絶縁層と、

前記第1絶縁層の下面に積層された第1配線層と、

前記第1絶縁層の下面に積層され、前記第1配線層が形成される配線形成領域よりも外側に位置する外周領域に形成された第1補強パターンと、

前記第1配線層及び前記第1補強パターンを被覆するように前記第1絶縁層の下面に積層された第2絶縁層と、

前記第2絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第1補強パターンに接して形成された第1補強ビアと、

前記第1補強ビアを介して前記第1補強パターンと接続され、前記第2絶縁層の下面に積層された第2補強パターンと、を有し、

前記第1補強ビアの底部の一部が、前記第1絶縁層に食い込んで形成されていることを特徴とする配線基板。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の一観点によれば、第1絶縁層と、前記第1絶縁層の下面に積層された第1配線層と、前記第1絶縁層の下面に積層され、前記第1配線層が形成される配線形成領域よりも外側に位置する外周領域に形成された第1補強パターンと、前記第1配線層及び前記第1補強パターンを被覆するように前記第1絶縁層の下面に積層された第2絶縁層と、前記第2絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第1補強パターンに接して形成された第1補強ビアと、前記第1補強ビアを介して前記第1補強パターンと接続され、前記第2絶縁層の下面に積層された第2補強パターンと、を有し、前記第1補強ビアの底部の一部が、前記第1

絶縁層に食い込んで形成されている。